

# NEWS RELEASE

2004年3月22日

## 同和鉱業より海外リードフレーム製造会社を譲り受け

日立電線株式会社（本社：東京都千代田区、執行役社長：佐藤 教郎、以下 日立電線）と同和鉱業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長・CEO：吉川 廣和、以下 同和鉱業）は、同和鉱業の連結子会社でリードフレームの製造を行っている DOWA Hightech Philippines, Inc.（出資：同和鉱業 80% 同和ハイテック株式会社 20%、本社：フィリピン共和国、以下 DHP 社）の全株式を、日立電線の連結子会社である日立ケーブルプレジジョン株式会社（本社：山形県米沢市、以下 日立ケーブルプレジジョン）および Hitachi Cable Singapore, Pte. Ltd.（本社：シンガポール、以下 HCS 社）が、4月30日付で譲り受けることで合意しました。

日立電線グループでは、日立ケーブルプレジジョンを核として、海外では HCS 社および Hitachi Cable PS Techno (Malaysia) Sdn. Bhd.（本社：マレーシア、以下 PS テクノ社）等で半導体リードフレーム事業を展開しております。最近、東南アジア地区は、半導体メーカーが数多く進出する等、半導体リードフレーム市場としての重要性が増大しつつあり、同地区において、HCS 社および PS テクノ社等に続く生産拠点を拡充することが当社グループの急務となっております。そこで当社グループでは、リードフレームの一貫生産メーカーとして実績を持つ DHP 社を新たにグループ会社に加えることで、東南アジア地区の需要に確実に応えていきたい考えです。

一方、同和鉱業は、同社が進める「事業の選択と集中」の一貫として、DHP 社の当社グループに対する譲渡を決定したものです。またこれにより、ユーザー及び DHP 社従業員に対する影響を最小限にとどめることが可能となります。

今後、当社グループでは、DHP 社を新たにグループ会社に加えることにより、汎用リードフレームの海外生産体制を強化する一方、日立ケーブルプレジジョンにおいて新構造パッケージ分野に傾注するなど、グループ内に素材から加工までの一貫製造体制を持つ強みを最大限に活かして、半導体パッケージ事業の強化・拡大を図ってまいります。

### <DHP 社の概要（2004年2月末日現在）>

1. 商 号：DOWA Hightech Philippines, Inc.
2. 所 在 地：フィリピン共和国カビテ州ダスマリニョス市
3. 代 表 者：取締役社長 永野 立男、2004年4月30日以降は日立電線グループより派遣
4. 設立年月：1994年12月
5. 資 本 金：100百万ペソ（200百万円：2円／ペソで換算）

6. 出資比率：同和鉱業 80%、同和ハイテック株式会社 20%  
　　<2004年4月30日以降>  
　　日立ケーブルプレジジョン 70%、HCS社 30%
7. 従業員数：265名
8. 売上高：554百万ペソ（2002年度 1,108百万円：2円／ペソで換算）

<日立ケーブルプレジジョンの概要（2004年2月末日現在）>

1. 商号：日立ケーブルプレジジョン株式会社
2. 所在地：山形県米沢市
3. 代表者：取締役社長 坂東 良則（日立電線より出向）
4. 設立年月：2002年12月1日
5. 資本金：400百万円
6. 出資比率：日立電線100%
7. 従業員数：342名
8. 売上高：39億円（2002年度）

＊日立ケーブルプレジジョンは、2003年度に日立電線より順次事業移管を受けており、2003年度の売上高は約96億円となる見込みです。

<HCS社の概要（2004年2月末日現在）>

1. 商号：Hitachi Cable (Singapore) Pte. Ltd.
2. 所在地：シンガポール ジュロング市
3. 代表者：取締役社長 中川邦夫（日立電線より出向）
4. 設立年月：1974年7月
5. 資本金：16百万シンガポールドル（1,008百万円：63円／シンガポールドルで換算）
6. 出資比率：日立電線グループ93%、ほか7%
7. 従業員数：361名
8. 売上高：176百万シンガポールドル（2002年度 11,088百万円：63円／シンガポールドルで換算）

<同和ハイテック株式会社の概要>

1. 商号：同和ハイテック株式会社
2. 所在地：埼玉県本庄市
3. 代表者：取締役社長 和田 宏
4. 設立年月：1947年3月
5. 資本金：450百万円
6. 出資比率：同和鉱業98%、ほか2%
7. 従業員数：186名
8. 売上高：44億円（2002年度）

以 上